

1-8-2 めっき面附着粘性異物起因(短絡) / 鍍层面附着粘性杂物的起因(短絡) / Caused by foreign adhesive objects on plated surface()

1-8-2-1 DFR スカム短絡 / DFR 余膜の短絡 / Short by dry film scum

【特徴】 めっき面のイレギュラー形状の短絡、単独短絡だけでなく複数短絡も見られる

【特征】 鍍层上有不规则形状的短路, 不仅有单独短路, 而且有多处短路。

【Characteristics】 Short in an irregular shape on the plated surface. More than one short is often seen.

【原因・判断ポイント・発生工程】 基板めっき面に DFR スカムが再附着して、ET レジストとなったことにより出来たもの（現像～ET 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 DFR 余膜再次附着在鍍层面成为 ET 剂而引起的（显影～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Dry film scum is adhered to the plated surface of a base material and acts as an etching resist, causing the defect. (Development - etching process)



【コメント】 顕微鏡倍率 × 175

【注釋】 显微镜倍率 × 175

【Comments】 Magnification: ×175



【コメント】 顕微鏡倍率 × 100

【注釋】 显微镜倍率 × 100

【Comments】 Magnification: ×100

1-8-2-2 ヘドロ短絡 / 粘性污泥的短絡 / Short by sludge

【特徴】 銅めっき面のヘドロ状ベタ短絡

【特征】 鍍铜面附着粘性污泥的短路。

【Characteristics】 Short of a wide area on the plated copper surface caused by sludge residue

【原因・判断ポイント・発生工程】 現像工程で付着したヘドロがめっき面に付着して、それが ET レジストとなった為できた短絡（現像～ET 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在显影工序发生的粘性污泥转移到电镀层, 成为 ET 剂而引起的短路（显影～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Sludge formed in development process adheres to the plated surface and acts as an etching resist causing the defect. (Development - etching process)



【コメント】 顕微鏡倍率 ×

【注釋】 显微镜倍率 ×

【Comments】 Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率 ×

【注釋】 显微镜倍率 ×

【Comments】 Magnification: ×